

裕太微电子  
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

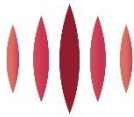
证券代码：688515

证券简称：裕太微

## 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT\_ZQSWB\_2024\_7\_3

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员单位名称及姓名	金世富盈（北京）投资有限公司，贾纯冶、吴松成
日期时间	2024年7月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘办顾问：程婧偲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p><b>一、介绍环节</b></p> <p>首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。</p> <p><b>二、互动交流环节</b></p> <p><b>1、如何看待目前的市场情况？</b></p> <p>答：近日，美国半导体产业协会（SIA）公布的最新的全球半导体市场数据显示，今年5月全球半导体销售额达491亿美元，比2023年5月的412亿美元大涨19.3%，相比今年4月的475亿美元增长4.1%。从今年5月全球半导体销售额的各区域表现来看，美洲市场表现最突出，较去年同期大涨43.6%；中国大陆同比增长24.2%、亚太/所有其他地区同比增长13.8%。随着未来半导体行业景气度的回升和下游需求的逐渐恢复，以及本土化所带来的需求，加上公司产品矩阵的不断丰富，叠加新品的放量以及工规</p>



级产品的去库结束，公司也将迎来更多的发展机会。

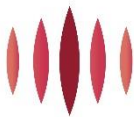
## 2、目前车上是否有大面积使用以太网协议的趋势？

答：工信部于近日发布《2024 年汽车标准化工作要点》，从健全汽车技术标准体系、加快关键急需标准研制等五方面提出 19 条具体任务。其中提到，加大智能网联汽车标准研制力度、强化汽车芯片标准供给等。随着汽车智能网联技术水平不断提高，通过国内自主标准的制定，不仅有利于国内相关产业规范化发展，也将助力国内汽车协议统一的趋势。车载以太网可以满足高速有线传输、车内协议统一、热插拔（即插即拔）、汽车降本、线束减重等多种需求。随着汽车智能化网联化程度的加深，各大车厂的整车架构逐步从分布式架构走向域架构，逐步走向以太网为网络骨干的第三代应用。后续车载以太网的系列产品，包括车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片等都将大大提升市场使用量。同时，随着导航辅助驾驶、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别等功能的逐步发展，且目前国内部分新能源品牌都已经具备并已上路使用，将在很大程度上进一步推动车载以太网快速渗透到汽车行业。公司目前车载百兆以太网物理层芯片和车载千兆以太网物理层芯片均已量产出货，车载以太网交换机芯片和车载网关芯片均在研发中，这将为以太网芯片在车载生态上提供助力，也将为我司未来提供汽车芯片整体方案增加竞争力。

## 3、公司车载以太网交换机芯片的研发进程如何了？

答：公司车载以太网系列中的百兆和千兆以太网物理层芯片均已量产出货，并已实现 2024 年上半年该产品线整体营收超过 2023 年全年该产品线营收的业绩成果。车载以太网交换机芯片原定将于 2025 年年底问世，经过公司车载研发人员补充以及车载事业部业务集中化后，该产品线首款产品将于 2025 年年初问世，较之预期提前了不少时间。后续，车载以太网交换机芯片的问世将进一步补齐公司车载以太网全系列产品，为公司在车载以太网全领域的市场部署提供更大的机遇。

## 4、车载以太网物理层芯片的生产过程？



	<p>答：车载以太网物理层芯片的生产过程涉及多个复杂且关键的步骤，以确保芯片的性能和可靠性达到高标准，主要可以概括为五个步骤。第一步设计和规划，根据车载以太网物理层芯片应用的功能和需求，对芯片的电路结构、布局、封装等进行设计、规划和仿真，以确保芯片能够满足车载通信的高速、高可靠、低功耗等要求。第二步是制版和刻蚀，利用光刻技术将设计好的芯片图案转化为光罩，并使用光刻技术，将光罩上的图案转移至硅片上，形成不同层次的半导体器件和互联线路。第三步是测试和分选，对制作好的硅片进行电性能测试，以检测芯片是否有缺陷或异常，以及是否符合设计规范。对于车载以太网物理层芯片，还会进行额外的耐高温、耐振动和电磁兼容性测试，以确保其在恶劣的车载环境中的可靠性。第四步是封装和贴片，将产品芯片与外部引脚或焊盘相连接，形成可以安装在电路板上的封装。封装的方式有多种，如球栅阵列、无引线芯片载体、塑料外延双列直插封装等。封装好的芯片被称为芯片组件，需要经过贴片机将其精确地贴在电路板上，形成车载以太网物理层模块。最后一步是调试，对车载以太网物理层模块进行功能调试，加载芯片所需的软件驱动，并检验模块是否能够正常工作，以及是否达到预期的通信效果。</p> <p><b>5、公司在员工职业健康方面的工作</b></p> <p>答：作为高科技研发类企业，员工主要工作场所为办公大楼。公司严格遵守国家在劳动安全和职业健康方面法律法规，投入大量人力物力，提供了充足、全面的健康福利保障，为员工营造舒适、安全的工作环境。公司通过健康医药箱、年度体检和补充商业保险等多个维度来综合保障员工的身心健康。2023 年度，公司无工伤人数，无工伤事故，未出现职业病发病员工。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单(如有)	无